

JIS

工業用金及び金合金めっき

JIS H 8620 : 1998

(2004 確認)

(2008 確認)

平成 10 年 11 月 20 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

まえがき

この規格は、工業標準化法に基づいて、日本工業標準調査会の審議を経て、通商産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって、JIS H 8620 : 1993は改正され、この規格に置き換えられる。

この規格の一部が、技術的性質をもつ特許権、出願公開後の特許権、実用新案権、又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会は、このような技術的性質をもつ特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権、又は出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について責任をもたない。

JIS H 8620には、次に示す附属書がある。

- 附属書1(規定) 硝酸ばっ気試験方法
- 附属書2(参考) 下地めっきの種類及び最小厚さ
- 附属書3(参考) めっき前の応力除去のための熱処理条件
- 附属書4(参考) めっき後の水素ぜい性除去のための熱処理条件

主 務 大 臣：通商産業大臣 制定：昭和 60. 3. 1 改正：平成 10. 11. 20
官 報 公 示：平成 10. 11. 20

原案作成協力者：社団法人 表面技術協会

審 議 部 会：日本工業標準調査会 非鉄金属部会（部会長 神尾 彰彦）

この規格についての意見又は質問は、工業技術院標準部材料機械規格課（☎100-8921 東京都千代田区霞が関1丁目3-1）にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第15条の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

工業用金及び金合金めっき

H 8620 : 1998

Electroplated coatings of gold and
gold alloy for engineering purposes

序文 この規格は、1985年に第1版として発行されたISO 4523, Metallic coatings—Electrodeposited gold and gold alloy coatings for engineering purposesを元に作成した日本工業規格であるが、対応国際規格には規定されていない試験片の作製、表示の項目を日本工業規格として追加している。また、10.6 耐食性試験の実環境条件については、我が国の環境条件(高温・多湿)に変更している。

1. 適用範囲 この規格は、金属及び非金属素地上に工業用の目的⁽¹⁾で行った、有効面の厚さ0.2 μm以上の金及び金合金電気めっき(以下、めっきという。)について規定する。

注⁽¹⁾ 工業用の目的とは、電気、電子、機械、その他の機能的部品などに用いることを目的としたもので、それぞれ特殊な性能が要求されるめっきをいう。

備考1. 成形された部品についてだけ適用する。

2. この規格の対応国際規格を、次に示す。

ISO 4523 : 1985 Metallic coatings—Electrodeposited gold and gold alloy coatings for engineering purposes

2. 引用規格 次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版を適用する。

JIS C 0050 環境試験方法—電気・電子—はんだ付け試験方法

JIS H 0400 電気めっき及び関連処理用語

JIS H 0404 電気めっきの記号による表示方法

JIS H 8501 めっきの厚さ試験方法

JIS H 8502 めっきの耐食性試験方法

JIS H 8503 めっきの耐磨耗性試験方法

JIS H 8504 めっきの密着性試験方法

JIS Z 2244 ビッカース硬さ試験—試験方法

JIS Z 2251 ヌーブ硬さ試験—試験方法

JIS Z 3282 はんだ

ISO 4524 : 1985 Metallic coatings—Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings

Part 1 : Determination of coating thickness

Part 2 : Environmental tests

Part 3 : Electrographic tests for porosity

Part 4 : Determination of gold content

Part 5 : Adhesion tests